

## 光碟內容說明

在 DMA-6410L 開發平台的產品光碟中包含了許多實用的東西，讀者可以從產品光碟的 README 文件瞭解光碟的內容，主要包含以下的內容：

上層目錄	說明
User Manual	平台的操作手冊 PDF 檔。
SCH	平台的電路圖，以 PDF 格式的檔案提供。
Datasheet	平台所採用電子元件的 Datasheet 文件。
WinCE6.0	包含以下子目錄： <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>BSP</b>。</li><li>2. <b>Sample Image</b>：在這個目錄應放置 EBOOT.bin、EBOOT.nb0、STEPLDR.bin、NK.bin 等映像檔。</li><li>3. <b>DEMO AP</b>：應用程式或 DEMO 程式的可執行檔，包含部分有開放的程式碼。</li><li>4. <b>SDK</b>：DEMO AP 及實驗程式所使用的 SDK。</li><li>5. <b>硬體編解碼 Demo 的 Source</b>，具體內容見第九章 9-2.2.6 的“MFC(硬解碼)”模式</li></ol>
Android	包含以下子目錄： <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Cross compiler</b>。</li><li>2. <b>U-boot</b>。</li><li>3. <b>U-Boot_MMC</b>：支援由 SD 卡啟動的 U-Boot 版本。</li><li>4. <b>Kernel</b>。</li><li>5. <b>Android</b>：Android 的程式碼，包含編譯 Android 的腳本文件等。</li><li>6. <b>Sample Image</b>：在這個目錄內應放置 u-boot.bin、zImage、ramdisk-uboot.img、system.img 及 userdata.img 等映像檔。</li><li>7. <b>NDK</b>：包含 Android NDK、cygwin 及一個 LED 控制的實驗範例。</li><li>8. <b>Lab</b>：包含以下項目<ol style="list-style-type: none"><li>(1) <b>Driver</b>：驅動程式的程式碼。</li><li>(2) <b>LIB_SO</b>：libXXX.so 的程式碼及二進位檔案。</li><li>(3) <b>AP_SDK1.6</b>：以 Android 1.6 SDK 開發的實驗程式碼等。</li></ol></li></ol>
Tools	包含以下項目： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 微軟公司的 <b>ActiveSync 4.5</b> 及 USB 驅動程式。</li><li>2. <b>ConvertZ</b>：這是繁簡中文轉換的工具。</li><li>3. 串列終端工具 <b>DNW</b> 及 USB 驅動程式。</li><li>4. <b>TFTPD32</b>：TFTP 伺服器的 Windows 版。</li><li>5. <b>IROM_Fusing_Tool</b>：製作啟動用 SD 卡的工具。</li></ol>